炬芯科技股份有限公司

关于端侧 AI 音频芯片新品推广的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布的基于存内计算技术的端侧 AI 音频芯片新品（以下简称“端侧 AI 新品”）已推出了 ATS323X、ATS286X、ATS362X 产品系列，其中 ATS323X 系列芯片在客户首款终端产品量产后短时间内快速起量，端侧 AI 新品推广取得阶段性成果。

为便于广大投资者了解公司端侧 AI 新品的推广情况，现将情况披露如下：

一、端侧 AI 音频芯片市场拓展情况

针对端侧 AI 专用模型应用场景，公司致力于满足 AIoT 设备低延迟、低功耗、高数据隐私性和个性化的要求，创新性采用了存内计算技术，在存储单元中完成存储和计算，消除了数据访存延迟和功耗，实现了存储与计算融合，带来能效比的显著提升。

公司端侧 AI 新品采用 CPU+DSP+NPU 三核异构的设计架构，其中 NPU 单核实现 100GOPS 的 AI 算力，能效比高达 6.4TOPS/W @INT8。目前，ATS323X 系列芯片顺利量产，已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户，在客户终端产品量产后短时间内快速起量，端侧 AI 新品推广已取得阶段性成果。此外，面向 AI 音频领域的 ATS286X、端侧 AI 处理器领域的 ATS362X 在多家头部品牌客户中已导入立项，未来可期。公司将继续加大端侧设备的边缘算力研发投入，推动 AI 技术在端侧设备上的融合应用，助力端侧 AI 生态健康、快速发展。

二、对公司的影响

端侧 AI 新品的快速导入，验证了公司对于 AIoT 产品升级趋势的判断和技术路线选择，是公司拥抱端侧产品 AI 化浪潮的标志性成果，随着上述各系列产品的持续推广，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在端侧 AI 音频领域的市场竞争

力、提升市场占有率，对公司长期发展奠定坚实的基础。

三、风险提示

目前公司端侧 AI 新品销量占公司整体出货量比例较低，同时销售情况受客户方案进展、市场拓展及竞争情况等多种因素影响尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日